附件2

**2024年“中国芯”优秀产品征集活动**

**优秀技术创新产品申报表**

**企业信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称****（中英文）** |  |
| **企业简介** |  |
| **企业销售额** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **企业人员规模** | **2023年** |  | **2024年****（上半年）** |  |
| **净利润****（大致的量级）** |  | **近三年企业研发投入占营业收入的比重** |  |
| **融资轮次** |  | **公司近两年有无上市意向（如有，请填写下行内容）** |  |
| **拟上市地（主板/中小板/创业板/科创板/其他）** |  | **上市进程（已改制/辅导中/已受理/其他）** |  |
| **现有人员学历情况占比** | （大专及以下、本科、硕士、博士占比情况） |
| **公司产品销售主要依靠：□公司自有销售团队 □委托分销代理商 □其他方式** |
| **联系人姓名** |  | **职务** |  |
| **地址** |  | **邮编** |  |
| **座机电话** |  | **手机** |  |
| **E-mail** |  | **传真** |  |
| **企业规模分类** | □大型 □中型 □小型  |
| **是否为“专精特新”企业** | □是（□国家级 □省级） □否 |
| **融资轮次** |  |
| **外扩需求** | □是 □否 |

**申报产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **申报产品名称及****型号/推出时间** | 名称：型号：推出时间： |
| 采用CPU架构 | □ Arm □ X86 □ Risc-v □ 其他：  |
| **产品应用场景分类** | □消费级 □工业级 □车规级 □其他：  |
| **申报产品****按功能分类** | □CPU □FPGA、DSP等计算芯片 □ GPU□基带芯片 □微控制器 □显示驱动 □图像传感器（CIS）□传感器□功率器件 □宽禁带半导体功率器件□音视频处理器 □无线连接芯片 □有线接口芯片 □电源管理芯片 □射频芯片 □光通信芯片 □存储芯片 □安全类芯片 □卫星导航芯片 □信号链类芯片□网络芯片 |
| **申报产品****按工艺分类** | 注：如CMOS、BCD、HV、Analog、RF、GaAs、MEMS等 |
| **参选芯片的知识****产权归属** | * 属于申请单位
* 属于母公司
* 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请注明）
 |
| **芯片概述** |  |
| **芯片体系结构图** |  |
| **封装形式** | 封装厂 |  | 封装/生产工艺 |  |
| **生产工艺** | 代工厂 |  | 生产工艺 |  |
| **主要性能和指标** | 注：请提交产品手册等资料 |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利项数** |  |
| **已获取专利项数** |  |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料 |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** | **销售量****（单位：万颗）** |
| **自产品推出之时起至今** |  |  |
| **2023年全年** |  |  |
| **2024年上半年** |  |  |
| **2024年全年预计** |  |  |
| **市场份额** | （注：根据市场总量实际估测） |
| **对标国外相关芯片产品的情况** | （注：请列出参选产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号） |
| **本产品的主要客户及应用案例介绍** |  |
| **法律声明：** **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |

**注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。**